# 驱动板V2.0硬件版本修改

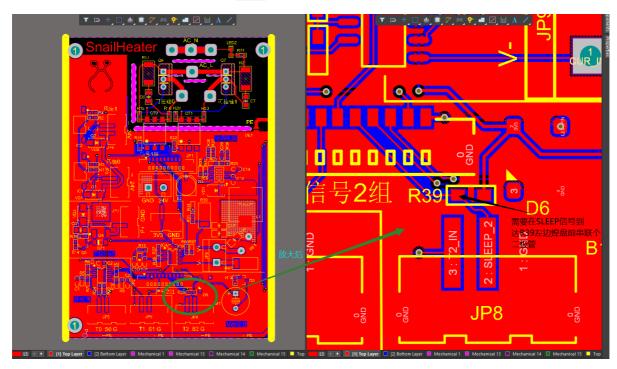
本教程只针对于V2.0版本的驱动板的修改,其他任何版本的PCB均不需要此操作!!!

由于驱动板V2.0设计上的不完善,导致了容易因为烙铁烧主控引脚,故所有持有驱动板V2.0的群友强制要修改。

## 目的

烙铁信号接口的S2处,在s2信号进入到R39电阻的左边焊盘前,需要串连一个二极管。

注:要求二极管的压降越小越好。建议 0.3v 压降的二极管。



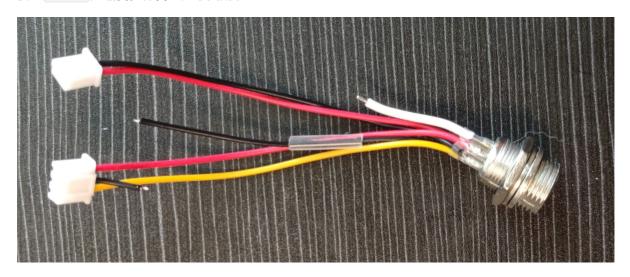
为此提供两种修改方案,<u>方案一</u>焊接简单,<u>方案二</u>整体性合理。两种方案原理是一样的,选择合适自己的就可以,任何不懂的可以发群里问。

### 方案一修改

方案的思路: 在连接线上处理。

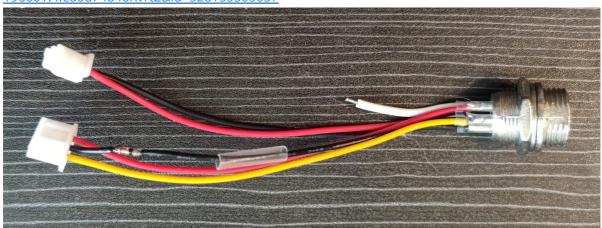
优点: 焊接难度低、风险低, 不需要修改板子。

1. 先在3pin的中间那根线头 0.5cm 或 1cm 处剪一刀。随后两端线头剥皮 (一点点就够) 、线头镀锡、套上 1.5cm 热缩管,待备。如下图所示:

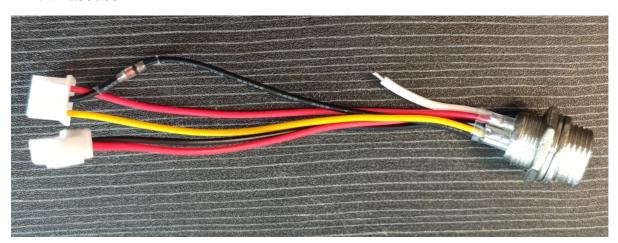


2. 二极管两端建议先上锡,将二极管焊在剪断的中间,注意二极管的负极朝着航空插的方向,焊接完需使用 万用表 测试二极管两端的压降,顺带确认方向。如下图所示:

二极管的购买连接 (压降约0.25v) <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997</a>
196601.4.ea6d7484oXvrt2&id=528155505657



#### 3. 加热热缩管缩管

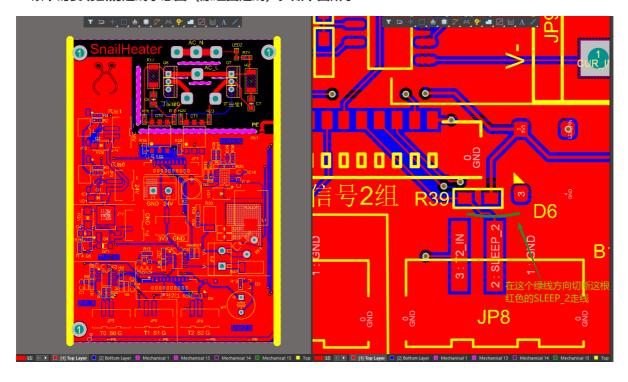


## 方案二修改

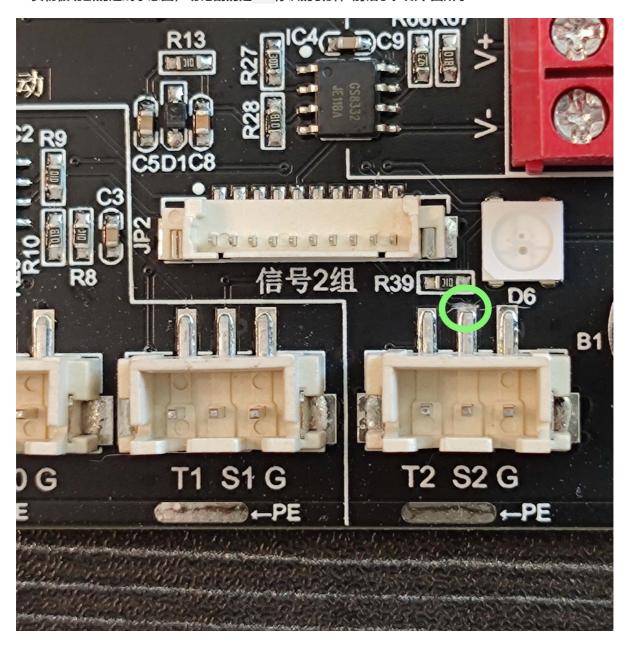
方案的思路:直接修改驱动板。切断部分走线串联二极管。

优点:整体性更优,修改原则上更合理。

1. 以下时要切断的走线示意图 (原理图走线) 。如下图所示:

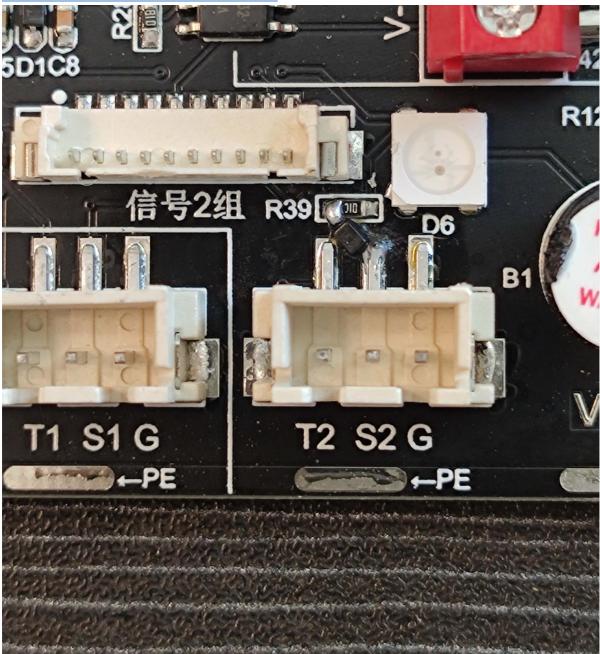


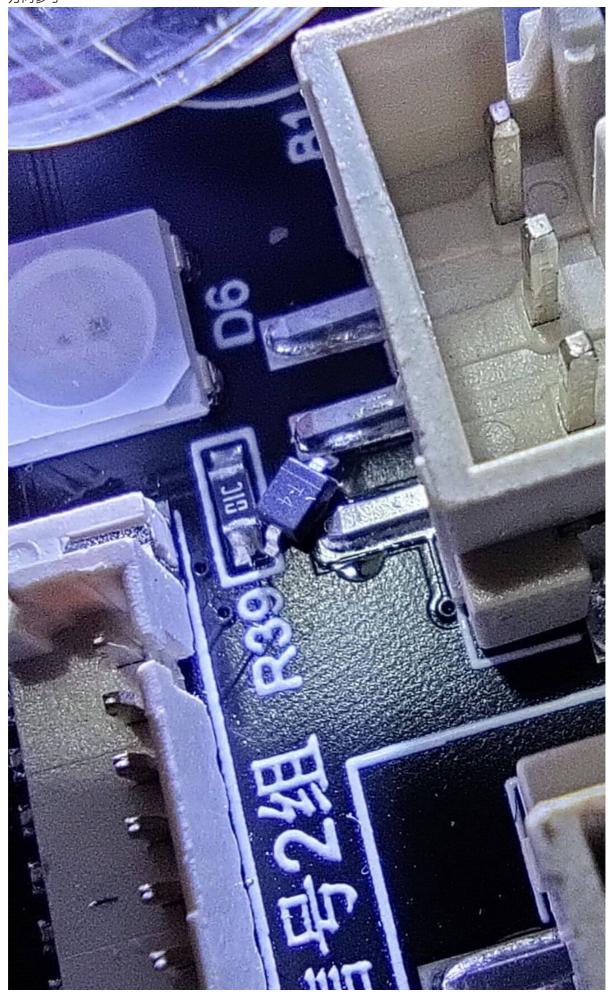
2. 实物板切断的走线示意图,切记割的是 S2 标识的引脚,别错了。如下图所示:



3. 二极管的负极接在3pin座的中间一脚上,二极管的正极与R39电阻的左端连接,焊接完需使用 万 用 表 测试二极管两端的压降,顺带确认方向。如下图所示:

二极管的购买连接 (压降约0.25v) <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997</a>
196601.4.ea6d7484oXvrt2&id=528155505657





# 核心板微小的优化

注:主要针对优化烙铁的休眠功能(软件上可以使用更好的休眠功能),可修改也可不修改。(目前修改方案只有一个)

在核心板模组从下往上数的第5个引脚串连一个 100nf(0.1uf/104) 电容, 电容的另一端连接到模组最上边的GND脚上。如下图所示:



注:由于主控模组的屏蔽罩也是 GND, 故也可以如下焊接方案 (更简洁):

